

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250429

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：年度及一季度投资者交流电话会议
参与单位名称及人员姓名	2025年4月29日上午 10:30~11:30：嘉实基金：曲海峰、赵宇；浦银安盛基金：高翔；信达澳亚基金：朱然；圆信永丰基金：胡春霞；理成资产：吴圣涛、周锐、卢超；睿郡资产：刘力、沈晓源；博时基金：曹芮；宏道投资：丁开盛；富国基金：林庆；国投瑞银基金：钟婷霞、马柯；常春藤资产：程熙云；易同投资：朱龙洋、党开宇、张科兵；野村国际（香港）：樊杨；SCHRODERS INVESTMENT：ZhengMaggie、LeeJack、YimChris、Amelia Wong 等，共 237 名投资者及证券人员。 2025年4月29日下午 14:00~15:00：南方基金：陈思臻。 2025年4月29日下午 16:00~17:00：财通基金：沈犁、张胤。
时间	2025年4月29日上午 10:30~11:30，下午 14:00~15:00、16:00~17:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待人员姓名	2025年4月29日上午：董事长朱双全先生、董事会秘书杨平彩女士、财务总监姚红女士 2025年4月29日下午：董事会秘书杨平彩女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司 2024 年度及 2025 年一季度经营情况，半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 2024 年主要经营情况如何？</p> <p>答：2024 年，公司营业收入、归母净利润双创新高，且归母净利润增幅强劲：实现营业收入 33.38 亿元，同比增长 25.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元，同比增长 134.54%。其中：半导体业务成为驱动公司业绩增长的重要动力，2024 年实现主营业务收入 15.2 亿元，CMP 抛光材料、半导体显示材料的收入增幅态势良好，从而带动公司整体利润水平大幅提升。</p> <p>而另一方面，2024 年因实施上市公司股权激励计划，计提股份支付费用，从而影响公司归母净利润 3,919 万元；此外，高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务尚属于市场开拓及放量初期，尚未盈利，虽一定程度上影</p>

响了本报告期的归母净利润水平，但为未来业务持续拓展布局打下良好基础。公司今年将以股权激励考核目标为导向，重点推进半导体相关材料业务的持续放量。

问 2：公司 2024 年研发投入继续增加，相关原因有哪些？

答：2024 年，公司研发投入金额 4.62 亿元，较上年同期增长 21.01%，占营业收入的比例为 13.86%。其中：已经放量的 CMP 抛光垫、半导体显示材料研发投入整体保持稳定，研发投入的增加主要系 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶业务对产品型号系统布局的要求较高，以及半导体先进封装材料、新领域芯片等新业务的投入。公司在半导体领域进行多元化的业务布局，虽然会在成长阶段因研发费用增加影响到归母净利润水平，但能在研发成果转化后推高公司未来业绩上限空间。公司将持续关注相关产品研发进程，努力保障在研产品的成果转化顺利进行。

问 3：公司 CMP 抛光垫业务的推进情况怎样，未来增长空间有哪些？

答：2024 年，公司 CMP 抛光垫业务实现产品销售收入 7.16 亿元，同比增长 71.51%；其中，第四季度实现产品销售收入 1.93 亿元，同比增长 28.77%。2025 年第一季度，公司 CMP 抛光垫实现产品销售收入 2.2 亿元，同比增长 63.14%，环比增长 13.83%，为逐季度持续放量打下了良好的基础。公司 CMP 抛光垫产品在国内市场的渗透程度随订单增长稳步加深，产品型号覆盖度高，核心原材料自主化的安全优势及成本优势明显，配合 CMP 抛光液、清洗液的系统化 CMP 材料解决方案服务能力强，国产供应龙头地位稳固。未来，公司将在本土外资及海外晶圆厂客户持续进行市场推广，并拓展硅晶圆及碳化硅用抛光垫，努力开启公司抛光垫业务新的市场增长曲线。

问 4：目前宏观经济形势变动对国产材料供应商有哪些机遇和挑战？

答：近期的关税政策等国际贸易形势变动，可能触发进口多元化和国产替代效应，从而推动国内泛半导体产业自主化程度进一步提升。但同时，下游客户对于国产材料供应商的产品型号覆盖率、原材料自主化率有了更严格的要求。公司作为半导体材料的国产供应商，业务布局覆盖 CMP 抛光材料、半导体显示材料、高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料，对标的进口替代产品线广，且上游核心原材料实现了自主可控，这有利于公司在新的贸易形势下加速开拓客户、提升市场份额，努力提高公司全年业绩。

问 5：公司半导体显示材料业务推进情况如何？

答：2024 年，公司半导体显示材料业务实现产品销售收入 4.02 亿元，同比增长 131.12%；其中，第四季度实现产品销售收入 1.20 亿元，同比增长 74.81%。2025 年第一季度，公司半导体显示材料实现产品销售收入 1.3 亿元，同比增长 85.61%，环比增长 8.48%，与下游重要面板客户的产品渗透和合作持续加深。公司 YPI、PSPI 产品的国产供应领先地位得到巩固，是国内部分主流面板厂客户的第一供应商；TFE-INK 产品市场份额也进一步提高。新产品方面，公司与国际一流厂商同步竞争，包括无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDF）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等材料的送样验证持续推进。

	<p>问 6: 公司 CMP 抛光垫、半导体显示材料放量速度快, 产能有瓶颈么?</p> <p>答: 公司前瞻性进行产能布局, 为持续增长的市场需求做好了产能保障。武汉本部抛光硬垫产线产能至 2025 年一季度末已提升至月产 4 万片左右(即年产约 50 万片), 为未来进一步放量销售做好产能储备。半导体显示材料方面, 仙桃产业园年产 1,000 吨 PSPI 产线投产并持续批量供应, 产能布局及生产体系能力提升; YPI 产品启动扩产计划, 在仙桃实施年产 800 吨 YPI 二期项目建设, 计划 2025 年内尽早完工试运行, 以缓解武汉本部 YPI 一期产能压力, 满足未来持续增长的产品订单供应。</p> <p>问 7: 公司 CMP 抛光液进展情况怎样?</p> <p>答: 2024 年, 公司 CMP 抛光液、清洗液业务累计实现产品销售收入 2.15 亿元, 同比增长 178.89%; 其中, 第四季度实现产品销售收入 7,502 万元, 同比增长 159.61%。公司 CMP 抛光液产品的核心原材料研磨粒子自主供应链优势凸显, 介电层、多晶硅、氮化硅、金属栅极等抛光液在客户端稳定放量供应, 铜及阻挡层抛光液在客户端验证持续推进, 搭载氧化铈研磨粒子的浅沟槽隔离抛光液已送至客户端验证, CMP 抛光液多系列产品布局持续完善。</p> <p>问 8: 公司其他新业务布局情况如何?</p> <p>答: 2024 年, 公司半导体封装 PI、临时键合胶、高端晶圆光刻胶产品均首获客户订单, 形成业务突破。其中: 高端晶圆光刻胶业务布局时间不到 3 年, 历经了从产品研发到导入、供应链自主化、应用评价及质量管理体系搭建、生产产线建设等工作, 整体推进速度是很快的。公司将在 2024 年取得首张订单的基础上, 持续进行半导体先进封装材料、高端晶圆光刻胶的市场推广工作, 努力加快相关产品的放量速度。</p> <p>问 9: 公司打印复印通用耗材业务的经营情况怎样?</p> <p>答: 2024 年, 公司打印复印通用耗材业务实现销售收入 17.9 亿元(不含打印耗材芯片), 较上年同期持平; 2025 年一季度受终端市场需求影响, 营业收入同比略降, 归母净利润同比收窄。公司持续推进成本挖潜、提升运营效率、降本增效等工作, 提升公司打印复印通用耗材业务综合竞争力, 积极推广市场, 保障打印复印通用耗材业务稳健运营继续进行。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 04 月 29 日